



錫膏 (NO./Clean SMT Solder Cream)

因應現代微間距時代來臨固品以其專業團隊積極開發正式進入 0.15m/mPitch 應用，其擁有之傲人技術能力，足以比美國際一流產品，同時我們也供應各種合金成份、粘度、顆粒大小之錫膏，可廣泛用於各種用途。

特點：

1. 出色的焊點光澤表現
2. 長時間印刷穩定性
3. 優秀的搖變能力無錫球產生
4. 經 4 0 項嚴荷要求，可滿足認何作業

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

規格表：

編號	15-01A	15-01B	23-01A	23-01B
合金組成	SN63/37PB	SN63/37PB	SN62/2AG/36PB	SN62/2AG/36PB
FLUX 含量	9.3%	9.3%	9.3%	9.3%
溶點	183℃	183℃	179℃	179℃
鹵素含量	0.02	0.02	0.02	0.02
粉末徑	20-45μm	20-38μm	20-45μm	20-38μm
粘數	170±10Pas	170±10Pas	170±10Pas	170±10Pas
適用	0402 高精密電子 使用	0201 0.15mm 微 間距	0402 高精密導電性良 好	微間距 0201QFP 通訊類 使用